

熱硬化型導電性ボンディングフィルム



※イメージはCBF-300

CBF[®]-300/-W6 CBF[®]-800-D40/-D60

安定した電気接続性、各種基材との優れた密着性を実現

スマートフォンのカメラモジュールやB to BコネクタをFPCに実装する際、裏打ち材である補強板を接着します。CBFを使用してFPCとポリイミド補強板を接着すると、CBFはシールド層として働きます。また、裏打ち材にNi-SUSなどの金属補強板を使用すれば、FPCのGNDを外部に引き出すことができます。

特徴

▶ 各種基材との優れた密着性

Ni-SUS等の補強板と優れた密着性を実現

▶ GND強化が可能

FPCのGND回路と金属補強板を電氣的に接続することで部品実装エリアのGND強化が可能

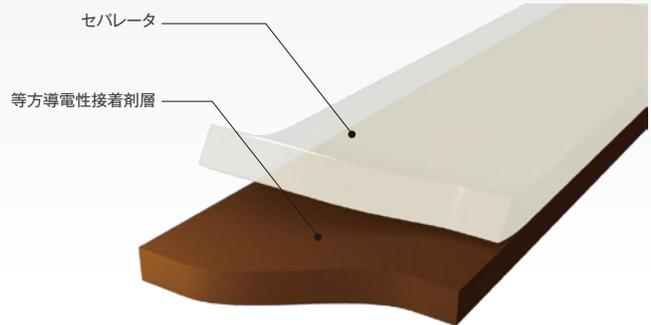
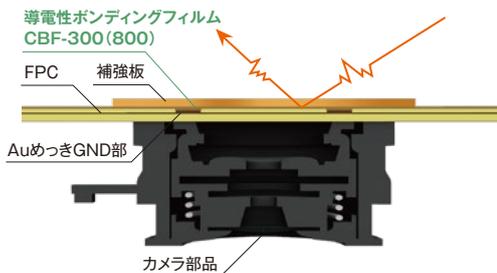
▶ 高温高湿耐性 (CBF-800)

85℃85%Rh試験においても高い接続信頼性を実現

こんなところで活躍します

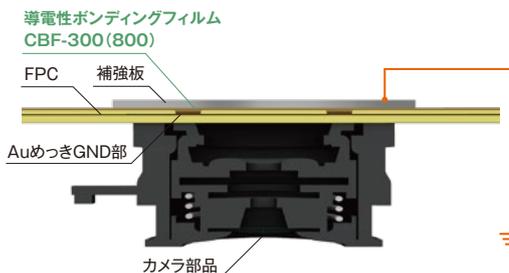
補強板がポリイミドの場合

CBF-300(800)がシールド層として機能する



補強板がNi-SUSの場合

FPCのGNDをNi-SUS経由で外部に取り出す



※イメージはCBF-300

代表スペック	CBF-300	CBF-300-W6	CBF-800-D40	CBF-800-D60
セパレータ厚み	38μm	57μm	50μm	50μm
製品総厚み	プレス前	40μm	60μm	40μm
	プレス後	22μm	42μm	28μm
接着強度	対Ni-SUS304	10.0N/cm以上		10.0N/cm以上
	対ポリイミド	10.0N/cm以上		10.0N/cm以上
製品ライフ(冷蔵)	4ヶ月		5ヶ月	